

柏騰科技 (3518)

法人說明會

日期：2026 / 07 / 08

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

大綱

CONTENTS

01

公司簡介

Company Overview

02

財務資訊

Financial Information

03

進度報告

progress report

04

營運展望

Operating status

05

資訊交流

Q&A

01

公司簡介

Company Overview

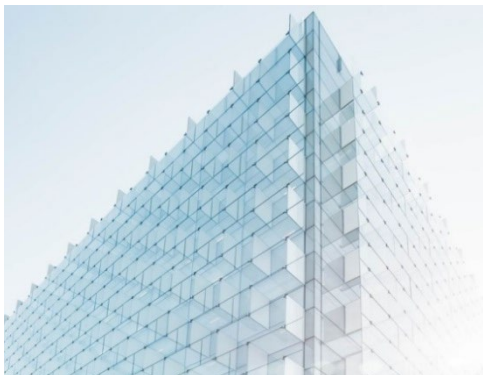
柏騰科技(3518)

柏騰科技（台灣證券交易所 | 股票代號3518）成立1995年，為全球首家將真空鍍膜(PVD)技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，近年積極轉型開發第三代半導體材料及先進製程技術，為業界少數同時具備生產碳化矽基板、真空鍍膜技術與製程開發的公司。



- ◆ 成立時間：84.10.20
- ◆ 資本額：102,467萬元
- ◆ 董事長：黃逸駿
- ◆ 總經理：游秀屏
- ◆ 目前主要產品及其應用：
 - 真空鍍膜(PVD) – 佔比99%
 - 碳化矽 (SiC) – 佔比 1%

關於柏騰



台灣總部&研發中心

- 成立時間：1995年
- 資本額：10億2千萬
- 台灣桃園市&中國蘇州



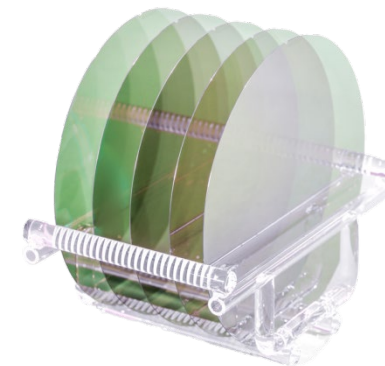
真空鍍膜(PVD)產品

防EMI&外觀鍍膜服務

- 南京廠/內江廠 (PVD鍍膜&設備)

種子層(Seed layer)PVD製程設備

散熱基板薄膜服務



碳化矽(SiC)產品

6~8吋碳化矽(SiC)晶圓

- 導電型 (N-Type / P-Type)
- 半絕緣型 (HPSI)
- 碳化矽散熱應用
- 晶錠加工&再生晶圓

12吋碳化矽晶圓(開發中)

發展歷程

柏騰為全球首家將真空鍍膜(PVD)技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，目前為NB防EMI最大供應商，2022年併購晶成材料擁有碳化矽(SiC)基板生產技術並進入第三代半導體供應鏈，2025年12月嘉義8吋SiC基板新廠完工，為業界少數同時具備碳化矽基板製造、真空鍍膜技術與製程開發的公司，在未來AI應用中碳化矽已成為未來半導體製程中最重要的材料，柏騰將結合碳化矽材料與真空鍍膜技術的優勢取得領先機會。



02

財務資訊

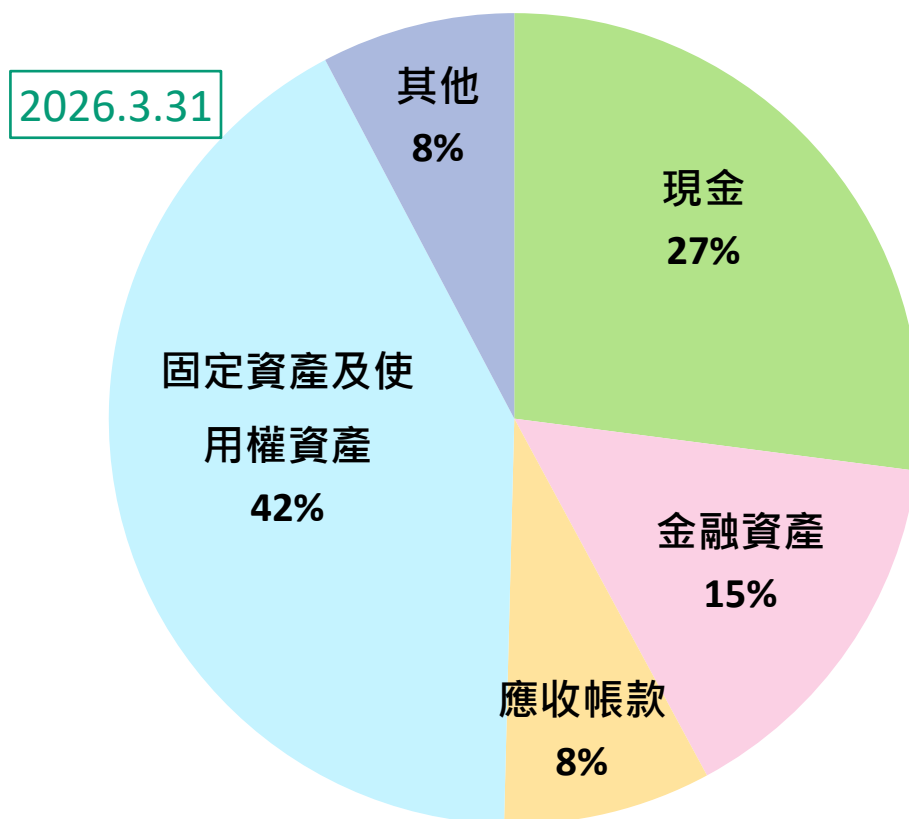
Financial Information

2026年第一季合併資產負債表

單位：新台幣佰萬元

	2026.3.31	%	2025.12.31	%	2025.03.31	%
現金及約當現金	661	27	443	20	753	36
金融資產-流動&非流動	368	15	379	17	407	20
應收帳款及票據	202	8	235	10	240	12
存貨	17	1	12	1	16	1
待出售非流動資產	0	0	10	0	10	0
固定資產及使用權資產	1,023	42	998	44	467	22
其他資產	172	7	169	8	184	9
資產總計	2,443	100	2,246	100	2,077	100
短期及一年內到期借款	179	7	249	11	174	8
其他應付款	102	4	101	4	78	4
應付公司債	292	12	290	14	286	13
長期借款	20	1	75	3	13	1
其他負債	147	6	131	6	146	7
負債總計	740	30	846	38	696	33
權益總計	1,703	70	1,400	62	1,382	67
每股淨值	16.60		13.64		14.25	

財務結構與比率



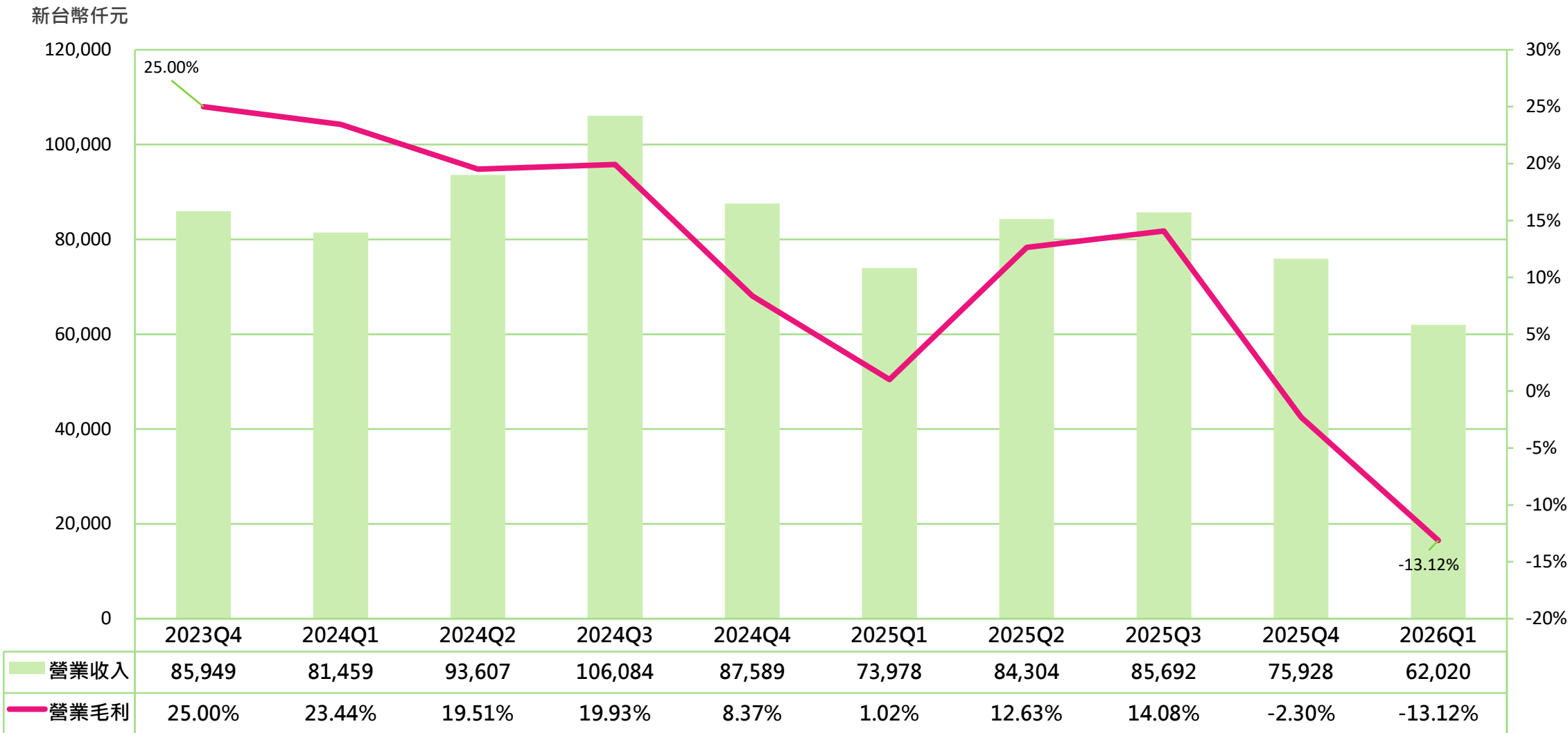
項 目	2026年Q1	2025年	2024年	2023年	2022年
負債比率	30.28	37.66	33.37	21.49	16.30
流動比率	400.58	296.46	511.45	395.27	606.50
現金流量比率	22.20	(52.25)	(33.46)	(17.17)	63.32

2026年第一季合併綜合損益表

單位：新台幣佰萬元

項目	2026年第一季	2025年第四季	增減	2025年第一季	增減
營業收入	62	76	(14)	74	(12)
營業毛利	(8)	(2)	(6)	1	(9)
營業費用	58	44	13	40	17
營業淨利(損)	(66)	(46)	(20)	(39)	(26)
營業外收支	365	(8)	373	(33)	398
繼續營業單位稅前淨利	299	(54)	354	(72)	371
所得稅費用	12	6	6	19	(7)
繼續營業單位本期淨利(損)	287	(61)	348	(91)	378
停業單位損失	(4)	(0)	(4)	1	(5)
本期淨損	283	(61)	344	(90)	374
毛利率(%)	-13%	-2%		1%	
純益率(%)	457%	-80%		-122%	
每股盈餘(元)	2.81	(0.63)		(0.94)	

收入與毛利率趨勢圖



2026年第一季合併現金流量表

單位：新台幣佰萬元

	2026年1月1日 至3月31日	2025年1月1日 至3月31日
營業活動之淨現金流入(出)	71	(241)
投資活動之淨現金流入(出)	259	(83)
籌資活動之淨現金流入(出)	(131)	(6)
匯率變動對現金及約當現金之影響	19	14
本期現金及約當現金增(減)數	217	(316)
期初現金及約當現金餘額	443	1,069
期末現金及約當現金餘額	\$661	\$753

重要事件說明

- ◆ 董事會通過現金增資子公司晶成材料新台幣1億元。(115.05.08)
- ◆ 子公司晶成材料股份有限公司公告決議辦理減資彌補虧損新台幣29,000萬元(115.05.08)
- ◆ 子公司精華國際投資有限公司公告決議辦理現金減資美金500萬元(115.05.08)
- ◆ 董事會通過115年度第一季合併財務報表，115年度第一季基本每股盈餘新台幣2.85元。(115.05.08)
- ◆ 子公司MACRO SIGHT INTERNATIONAL CO., LTD.決議發放股利人民幣2,000萬元。(115.04.29)
- ◆ 董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，私募額度不超過25,000,000股之額度，授權董事會自股東會決議之日起一年內分二次辦理。(115.04.14)
- ◆ 董事會決議114年度不分派股利。(115.04.14)
- ◆ 子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight Technology Limited決議發放股利人民幣2,000萬元。(115.04.10)
- ◆ 子公司精華國際投資有限公司完成出售其子公司柏靈(蘇州)光電科技股份有限公司100%股權，出售價款人民幣7,073萬元。(115.03.30)
- ◆ 董事會通過114年度合併財務報表，114年度累計基本每股虧損新台幣1.58元。(115.03.09)

03

進度報告

progress report

SiC新廠計劃-全面量產延至2027年首季

- ◆ 新廠位置：嘉義大埔美智慧型工業園區
- ◆ 主要產品：8吋導電型及6~8吋半絕緣SiC晶圓
- ◆ 新廠產能：3,000pcs/月(27H1) 6,000pcs/月(28H2)

2024H2 (規劃期)

ISO9001及14001認證
目標客戶送樣認證
開始建置新廠廠務及工程
導入先進8吋長晶製程設備，縮短製程開發時間

2025 (建置期)

- Q1進行廠務工程
- Q2進行行政樓工程
- Q3廠務工程完工
- Q4廠務設備系統測試及二次配工程啟動
- 6吋高純半絕緣型SiC
- 8吋導電型SiC

2026 (準備期)

- Q1加工設備安裝驗機
- Q2南崁廠長晶設備移機切磨製程試生產
- Q3長晶設備裝試機
- Q4長晶製程試生產
- 取得工廠登記證
- 通過指標性客戶廠驗
- 8吋高純半絕緣型SiC
- 8吋SiC基板薄化技術
- 6~8吋SiC熱散基板

2027~2028 (爬坡期)

- 通過IATF 16949認證
- 27年Q1產能1200/月
- Q2產能3000/月
- 27年H2啟動第二階段擴產
- 28年H1設備開始進廠安裝
- 28年H2產能6000/月
- 建置12吋SiC產能
- 6~8吋SiC加工服務
- SiC晶圓再生服務
- 大尺寸SiC散熱基板

新廠進度說明

工廠登記進度說明

截至目前已取得建物使用執照及部分環評許可，但仍有部分環評申請尚審核中，預計26年Q4取得工廠登記證，新廠全面量產時間將延至2027年首季，因應量產時程的延遲，今年仍會持續部分委外加工方式來因應客戶批量試樣出貨需求。

試量產進度說明

加工設備已全數安裝完成，切片、減薄製程已從26年Q2開始進行批量試產，因工廠尚無法排放廢水，影響後段拋光與清洗工段無法試量產，現階段採取部分委外方式進行。南崁廠長晶設備已完成移機作業，新購長晶爐從6月開始陸續到新廠安裝，計劃於9月底前可以試生產完成裝機。

產品驗證進度

8吋導電型產品

多家客戶進行產品驗證，目前國內指標客戶已通過產品驗證待客戶進行批量驗證，國外指標性客戶目前進行批量試產。

SiC散熱基板產品

產品通過國內指標性客戶驗證，待客戶進行終端客戶驗證後預計26年H2進行小批量試產。

業務開發進度

- 8吋導電型SiC基板銷售-小批量出貨
- SiC散熱基板 – 等待客戶小批量試產
- 6~8吋SiC基板加工服務-待27年H1
- 6~8吋SiC晶圓再生服務-待27年H1
- 先進製程散熱應用 (SiC+PVD) -開發中

04

營運展望

Operating status

產品發展方向與開發進度



- 高壓電源
- 儲能/綠能系統
- EV

N-Type

P-Type

- 散熱載板
- AI 應用-高功率高散熱
- 衛星、雷達
- 軍事應用

HPSI

- TGV(玻璃通孔技術)
- TSiCV(碳化矽通孔技術)
- 先進封裝散熱材料應用
- 表面平整及薄化技術

PVD

8吋導電型

6~8吋半絕緣

SiC 散熱應用

PVD + SiC

營運展望

EMI 鍍膜產品現況

因主要客戶接單影響及NB市場銷售不佳影響，截至上半年營收衰退約2成，預估下半年影響仍然存在，因受到成本巨大壓力，NB價格調漲後銷售帶來變數，2026年下半年營收仍面臨衰退風險。

SiC晶圓產品現況

8吋SiC導電型產品已開始小批量出貨，受惠AI產品及高功率元件需求增加，8吋需求快速增溫，後續搭配客戶訂單進行備貨。
6吋散熱基板已提供客戶進行試樣，待終端客戶產品驗證，預計下半年進行批量試產。
隨8吋導電產品小批量出貨，預估全年SiC產品營收佔往5%~10%。

轉向PVD先進製程技術應用

研發重心移回台灣，台灣建置一台PVD量產線配合客戶開發先進製程技術，目前合作開發產品有:ABF、TGV、TSiCV等鈦銅種子層、特殊功能散熱膜，加速未來半導體先進製程的應用，提供客戶製程設備與技術服務。

SiC中長期成長動能強勁

從電動車驅動系統到AI資料中心電力架構，SiC具有高散熱與耐高壓的特性，奠定未來導電與散熱材料的主導地位，SiC除了成為高壓電力系統的標配，還能解決AI產業最頭痛的「熱」問題，因應AI發展開啟中長期強勁剛性需求。

05

資訊交流

Q&A

TRUE PARTNER FOR A BRIGHTER FUTURE

發言人：劉明怡 財務處執行副總經理

電話：(03)212-8833

E-mail：mingi@pttech.com.tw

